

深圳市联得自动化装备股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券简称：联得装备

证券代码：300545

编号：2024-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	华夏基金、景顺长城基金、红杉资本股权投资管理、中国人寿养老保险、广发证券、光大证券、国信证券、招商证券、交银施罗德基金、昊青资产管理、国元证券、汇华理财、SMAM 三井住友投资管理(香港)、上海尚雅投资管理、深圳正圆投资、广东海辉华盛证券投资基金、广州玄甲私募基金、东兴基金、大家资产管理、同方证券、上海留仁资产管理、长城财富资产管理、江苏瑞华投资、青岛金光紫金创业投资管理、海富通基金、建信基金、国融基金、深圳前海华杉投资管理、新疆前海联合基金、方正富邦基金、发展研究中心、闻天私募证券投资基金、深圳市凯丰投资管理、汇丰晋信基金、浙江巴沃私募基金、深圳民森投资、晋江市晨翰私募基金、招商信诺资产管理、华泰柏瑞基金、友邦人寿保险、上海聆泽投资管理、淳厚基金、融通基金、青骊投资管理、长盛基金、上海合道资产管理、重庆市金科投资、进门财经、玄元私募基金等 60 位机构投资者
时间	2024 年 6 月 11 日
地点	线上：电话会议
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理：胡金先生 董事、董事会秘书：刘雨晴女士 财务总监：曾垂宽先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、介绍公司概况 简要介绍公司及子公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩，公司及子公司的核心优势及未来发展规划等情况。 二、投资者会议问答交流 Q1：公司的业绩持续提升的原因是什么？ A1：公司的业绩持续提升的主要原因是：一是公司坚持创新驱动，加

强前瞻性技术布局，并加速技术优势到产品的转化，优化产品结构，实现国产替代是公司业绩增长的主要因素。二是公司积极开拓海外市场，坚持差异化和高端化定位，实现了设备在欧洲、东南亚、北美的落地。凭借卓越的设备性能、先进的技术水平、精湛的工艺设计、强大的交期掌控能力和完善的售后服务体系获得了海外大客户的广泛认可。三是公司的产品向多元化发展，半导体设备和新能源设备业务成长性初显，打开了新的增长空间。四是公司持续优化管理流程，提升研、产、供、销的联动效率，不断强化内部协同，提升运营效率。坚持推行降本增效举措，推行精细化成本核算与管理，通过开源和节流相结合，提升人均创利水平。五是优秀的人才战略与企业文化驱动公司高质量和可持续发展。

Q2: 公司有哪些竞争优势?

A2: 公司主要从事新型半导体显示智能装备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备、锂电装备的研发、生产、销售及服务。公司深耕半导体显示设备行业二十余年，经历了显示产业的多种技术变革，通过多年的技术沉淀和积累实现了半导体显示产业各种技术之间的掌握和融合，具备了良好的产品研发设计能力和制造工艺水平，使公司的产品研发设计能力、产品质量性能均处于行业前列。公司凭借优异的产品质量和多年来积累的核心技术优势，以及全方位的、高质量的售前、售中、售后个性化、定制化服务，公司在业内树立了良好的口碑，公司已经拥有一批具有长期稳定合作关系的客户，与包括大陆汽车电子、博世、京东方、维信诺、深天马、德赛西威、华星光电、苹果、华为、富士康、夏普、业成、蓝思科技、惠科等知名企业建立了良好的紧密的合作关系。公司凭借行业经验优势、研发创新优势、品牌优势、综合服务优势、客户资源优势，实现了公司经营规模及业绩的稳定增长。

Q3: 公司在半导体领域的主要设备有哪些?

A3: 公司在半导体领域主要生产半导体后段工序的封装测试设备。主要产品是 COF 倒装机、半导体倒装机、软焊料固晶机、共晶固晶机、AOI 检测机、引线框架贴膜机等高速高精的半导体装备。目前共晶、软焊料等固晶机和 QFN 引线框架贴膜、引线框架检测等设备已经交付客户量产。公

	<p>司将密切关注行业发展动态和前沿技术的发展趋势，积极创造并把握半导体设备领域的发展机遇。</p> <p>Q4：公司在 Mini LED 显示领域的竞争格局和发展情况如何？</p> <p>A4：继 OLED 显示技术后，Mini LED 是近年来新兴的下一代显示技术，目前正处于快速发展的阶段，预计未来几年会保持高速增长。公司目前在 Mini LED 领域，已经推出芯片分选设备、芯片扩晶设备、检测设备、真空贴膜设备、芯片巨量转移设备、高精度拼接设备等。</p> <p>Q5：公司目前在手订单情况如何？产品确认收入节奏如何？</p> <p>A5：截至 2024 年第一季度公司在手订单充裕。公司设备根据订单约定的发货时间、运送方式发出产品后，以客户调试并完成验收作为所有权及风险的转移时点，进而确认收入。</p> <p>Q6：公司未来的发展方向是什么？</p> <p>A6：公司将持续加强在半导体显示模组设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备及新能源装备领域的研发。积极开拓柔性显示模组设备及显示前端工序贴合类设备、Mini/Micro LED 设备、VR/AR/MR 精密组装设备、汽车智能座舱系统装备、半导体封测设备以及新能源装备在新兴领域的应用市场，同时继续加大这些领域的新技术、新产品研发力度，支撑该业务快速成长。公司将通过多维度的产品布局，丰富产品种类，完善产品体系，通过内延发展孵化研发技术团队模式，形成稳健持续的发展平台。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024-6-11